



Dickdraht Wedge-Wedge Bonder 5850

Bond System

Drahttypen	Aluminiumdraht 100-500µm auf 4"-Spule Kupferdraht 100-300µm auf 4" Spule
Bondkopf	Dickdraht Wedge-Wedge Front- oder Backcut Standardwedges von 2" Länge, (optional 90mm) Motorisierte Drahtabspulung (optional) Programmierbares Voice-Coil Bondkraftsystem Von 0 bis 1.800 cN
Ultraschall System	F&S US System 60kHz (optional 40, 90, 120kHz)

Maschinen Basis

Achsen	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsbereich X/Y-Achse 200x150mm Schrittauflösung 1µm programmierbar Programmierbare Z-Achse mit 100mm Hub
Hardware	<ul style="list-style-type: none"> Dual-Core PC mit Windows OS Ethernet, USB 2.0/3.0, LCD Farbdisplay 22" GigE-CMOS-Farbkamera mit 5 MPixel Netzwerkfähig mit Programm-Archivierung
Software	<ul style="list-style-type: none"> Einzelbonds bis komplexe Programme, Loopformen in Bibliotheken speicherbar Optionale Bilderkennung
Steuerung	<ul style="list-style-type: none"> Hochleistungsembedded ARM-System mit Echtzeitbetriebssystem für Präzisions-Bahnkurven 1 Draht / Sekunde
Abmessung	B x T x H – 92 x 71 x 65 cm, Gewicht ca. 80kg
Anschlüsse	100-240 VAC, 1 Phase, 50/60 Hz, max 230 VA, Ø 6mm Standard-Vakuumschlauch
Heizung	Steuerung in der Maschine integriert 0-250 °C

Die 58xx Serie:

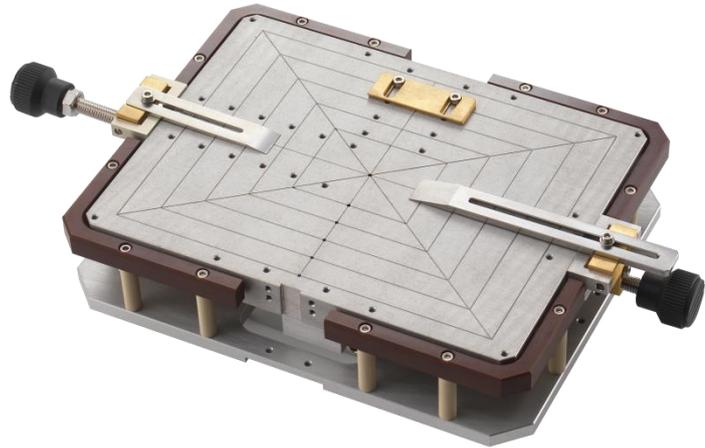
Die Dickdraht-Wedge-Wedge-Variante der automatischen Drahtbonder unserer Serie 58xx mit austauschbaren Bondköpfen.

Ideal geeignet für die Fertigung, da automatisch einsetzbar mit einer Bondgeschwindigkeit von typisch ein Draht pro Sekunde. Bauteilwechsel durch Bediener, der Bondablauf ist dank eingebauter Bilderkennung völlig bedienerfrei.

Einzelbonds sind in Sekunden herstellbar, daher auch perfekt für R&D, Pilotfertigung und Serienfertigung mit mittleren Losgrößen geeignet!

Substrathalter

Standard-Substrataufnahme
für Bauteile bis 8x6" mit
Vakuum und mechanischer Klemmung



Optional:



Vakuumaufnahme 6x6"
mit mechanischer Klemmung



TO Aufnahme mit
mechanischer Klemmung



4x4" Substrataufnahme m.
gummierter Oberfläche, mit
mechanische Klemmung

F&S Bondtec Semiconductor GmbH

Industriezeile 49a

A-5280 Braunau am Inn

Tel.: +43-7722-67052-8270

Fax: +43-7722-67052-8272

Mail: info@fsbondtec.at

Web: www.fsbondtec.at

Hilpert
electronics

Ihr Vertriebspartner/ Votre représentant:

Hilpert electronics AG

Täferstrasse 29

5405 Baden-Dättwil

Schweiz / Suisse

Tel: +41 56 483 25 25

Fax: +41 56 483 25 20

Mail: office@hilpert.ch

Web: www.hilpert.ch

